



京鼎精密科技股份有限公司

2026第二季法人說明會

2026/09/09

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

會議議程

- 公司簡介
- 財務報告
- 營運與展望
- 問答交流

李貞誼

發言人

鍾曉佩

副處長

鄒永芳

財務長

李貞誼

發言人

徐朝煌

副 總

黃俊凱

協 理

洪政維

協 理

鍾曉佩

副處長



陳偉銘

董事長



邱耀銓

執行長

主要業務

- 半導體前段製程設備關鍵模組及零部件製造服務
- 半導體設備及零部件再生循環
- 半導體自動化設備之研發、製造及銷售並提供整合性解決方案
- 醫療設備製造及設計服務

全球佈局 區域製造



2001

成立

2015

上市(3413 TT)

4,524 員工人數

截至2026/06/30

NT\$ 11.08億 股本

截至2026/06/30

NT\$ 366.07億 市值

截至2026/06/30

2026年上半年營收

NT\$118.61億

+17.8% YoY

2026年上半年毛利率

23.0%

-3.7 ppt YoY

2026年上半年EPS

NT\$ 8.89元

-12.1% YoY

全球佈局



生產基地：橫跨 4 區 8 廠

量產製造基地

松江廠, 上海

昆山廠, 江蘇



科中廠(HQ), 竹南



科研廠, 竹南



牛埔廠, 新竹



新產品開發中心

矽谷廠, 美國



銷售及服務辦公室

San Jose/ Austin/
Phoenix, 美國



量產製造基地

羅勇廠, 泰國

春武里廠, 泰國



江蘇

上海

台灣竹南總部

泰國

新加坡

加州

亞利桑那州

德州

- 量產製造基地 - 台灣/ 泰國/ 中國大陸
- 新產品導入與小量生產據點 - 美國
- 銷售及服務辦公室 - 台灣/ 美國/ 中國

財務報告

綜合損益表



單位：新台幣百萬元	2Q26		1Q26		QoQ%	2Q25		YoY%	1H26		1H25		YoY%
營業收入淨額	6,300	100.0%	5,562	100.0%	13.3%	5,203	100.0%	21.1%	11,861	100.0%	10,072	100.0%	17.8%
營業毛利	1,404	22.3%	1,326	23.8%	-1.5 pts	1,358	26.1%	-3.8 pts	2,730	23.0%	2,688	26.7%	-3.7 pts
營業費用	(634)	(10.1%)	(599)	(10.7%)		(481)	(9.2%)		(1,233)	(10.4%)	(934)	(9.3%)	
營業利益	769	12.2%	727	13.1%	-0.9 pts	877	16.9%	-4.7 pts	1,496	12.6%	1,754	17.4%	-4.8 pts
營業外損益	(76)	(1.2%)	34	0.6%		(456)	(8.8%)		(42)	(0.3%)	(372)	(3.7%)	
稅前淨利	693	11.0%	761	13.7%	-2.7 pts	421	8.1%	+2.9 pts	1,454	12.3%	1,381	13.7%	-1.4 pts
本期淨利	555	8.8%	519	9.3%	-0.5 pts	391	7.5%	+1.3 pts	1,073	9.0%	1,115	11.1%	-2.1 pts
歸屬予：													
母公司股東	511		473		8.0%	369		38.6%	984		1,093		-9.9%
基本每股盈餘(元)	4.61		4.28		0.33	3.41		1.20	8.89		10.11		(1.22)
加權平均流通在外股數(百萬股)	110.79		110.64			108.17			110.71		108.04		

資產負債表及重要財務指標



單位：新台幣百萬元

	2Q26		1Q26		2Q25	
現金及流動金融資產	7,218	24%	8,673	29%	7,543	29%
應收帳款	2,758	9%	2,120	7%	1,815	7%
存貨	5,671	19%	4,800	16%	3,904	15%
長期投資	499	2%	342	1%	438	2%
不動產、廠房及設備	10,466	35%	10,552	35%	8,016	31%
無形資產	1,534	5%	1,554	5%	2,425	9%
資產總計	30,322	100%	30,215	100%	26,062	100%
應付帳款	2,265	7%	2,063	7%	1,359	5%
銀行借款	5,526	18%	5,119	17%	2,829	11%
應付公司債	-	0%	-	0%	222	1%
流動負債	9,992	33%	10,971	36%	7,311	28%
負債總計	12,291	41%	12,836	42%	10,077	39%
股東權益總計	18,031	59%	17,379	58%	15,985	61%
重要財務指標						
平均收現天數	33		30		32	
平均銷貨天數	105		103		99	
平均付現天數	37		38		38	
淨營運現金週期天數	101		95		93	
流動比率(倍)	1.66		1.50		1.88	

現金流量表



單位：新台幣百萬元	1H26	1H25
期初現金	6,626	7,527
營運活動之現金(流出)流入	(99)	414
資本支出	(1,441)	(2,119)
現金股利	(1,217)	-
企業合併現金淨支付數	-	(1,263)
定期存款	707	276
銀行借款淨變動	1,861	908
其他	78	(65)
期末現金	6,515	5,678
自由現金流量*	(1,540)	(1,705)

*自由現金流量=營運活動之現金流入-資本支出

營運與展望

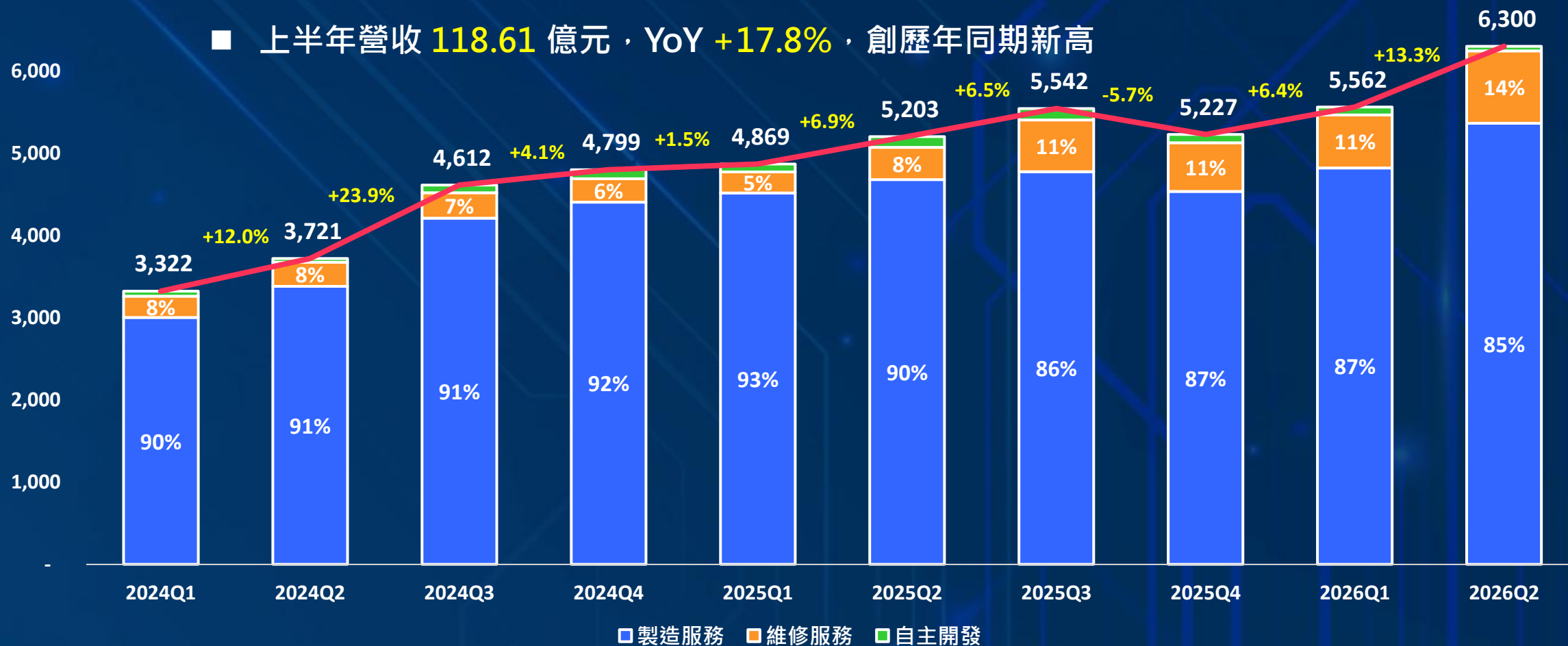
營收趨勢



■ Q2 營收 63.00 億元，YoY +21.1%、QoQ +13.3%，創單季新高

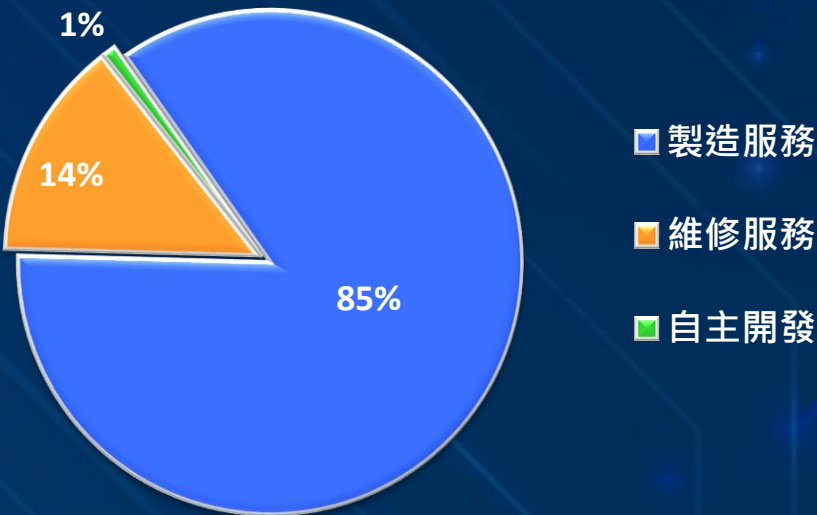
■ 上半年營收 118.61 億元，YoY +17.8%，創歷年同期新高

單位：台幣百萬



註：製造服務=半導體製程設備關鍵模組、零部件與備品耗材製造
維修服務=半導體與航太維修
自主開發=半導體自動化設備

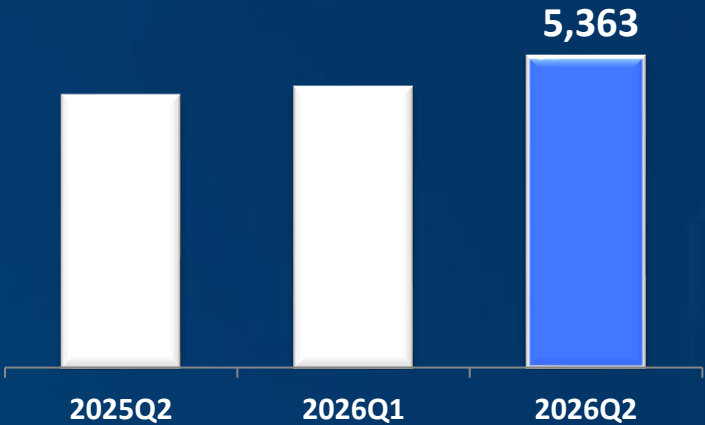
2026年第二季銷售分析-業務別



單位：台幣百萬

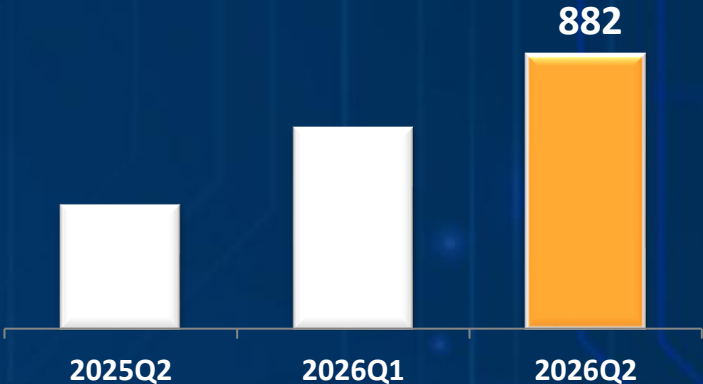
製造服務

+11.2% QoQ
+14.6% YoY



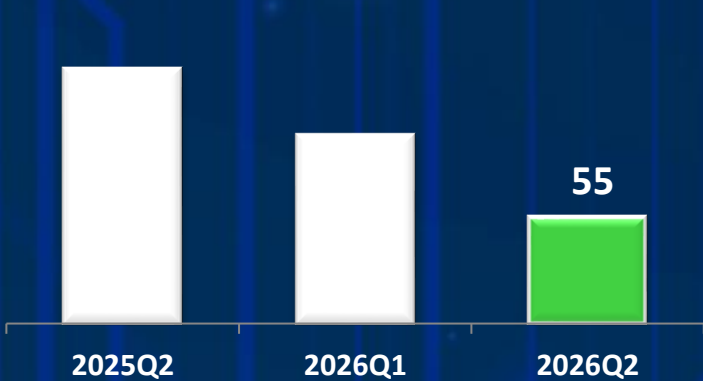
維修服務

+37.2% QoQ
+124.7% YoY



自主開發

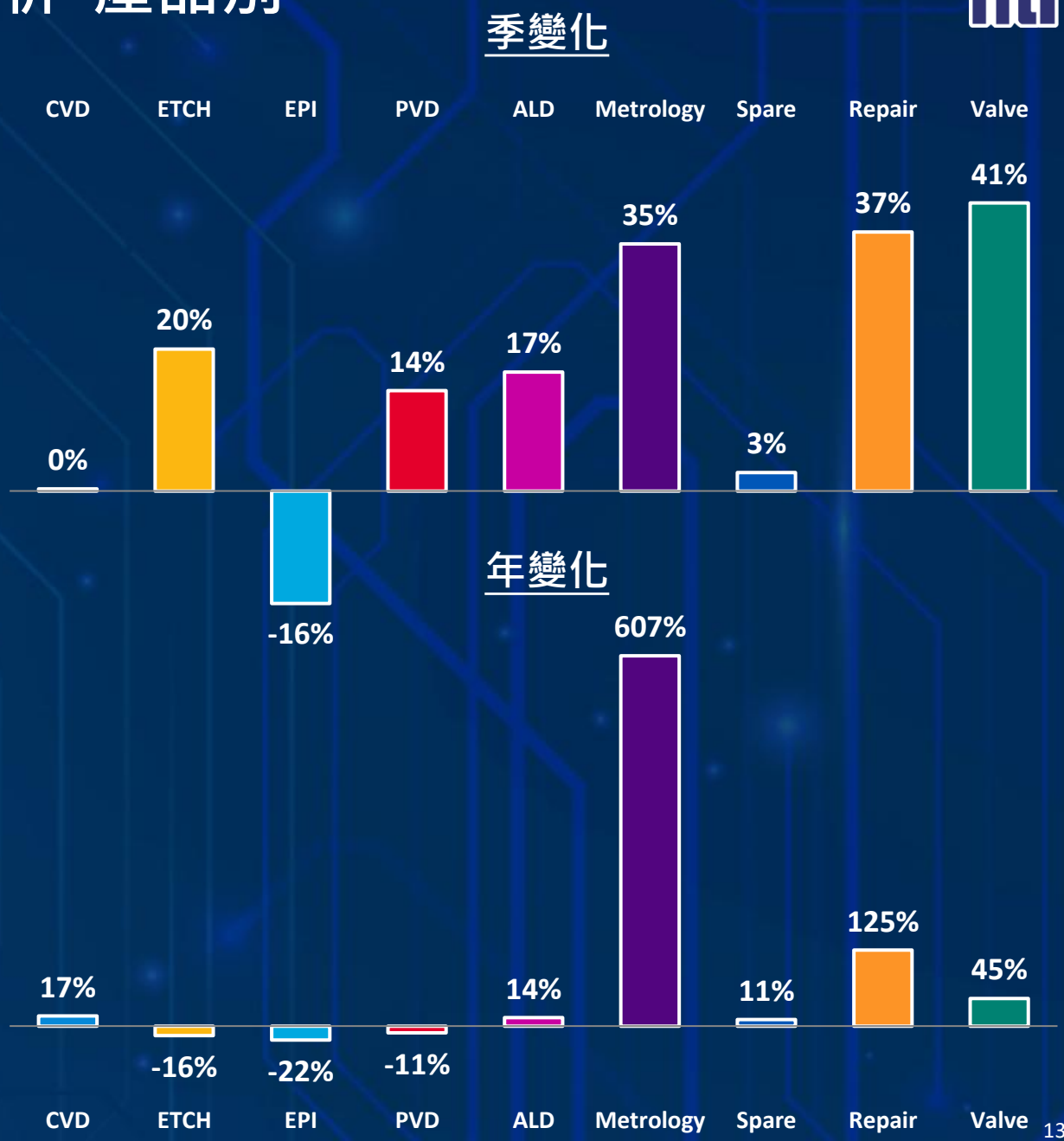
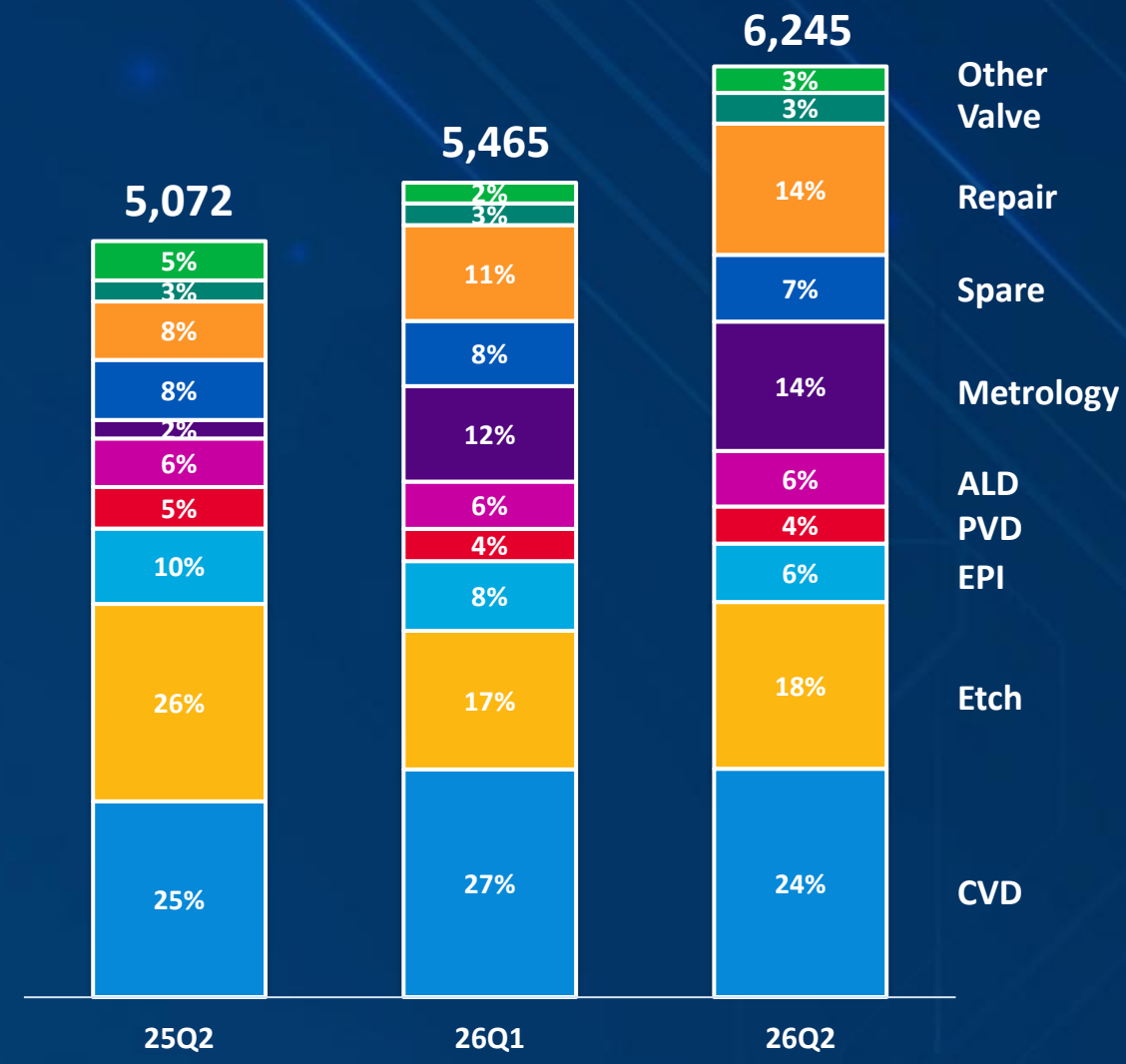
-43.6% QoQ
-58.3% YoY



2026年第二季製造及維修服務銷售分析-產品別



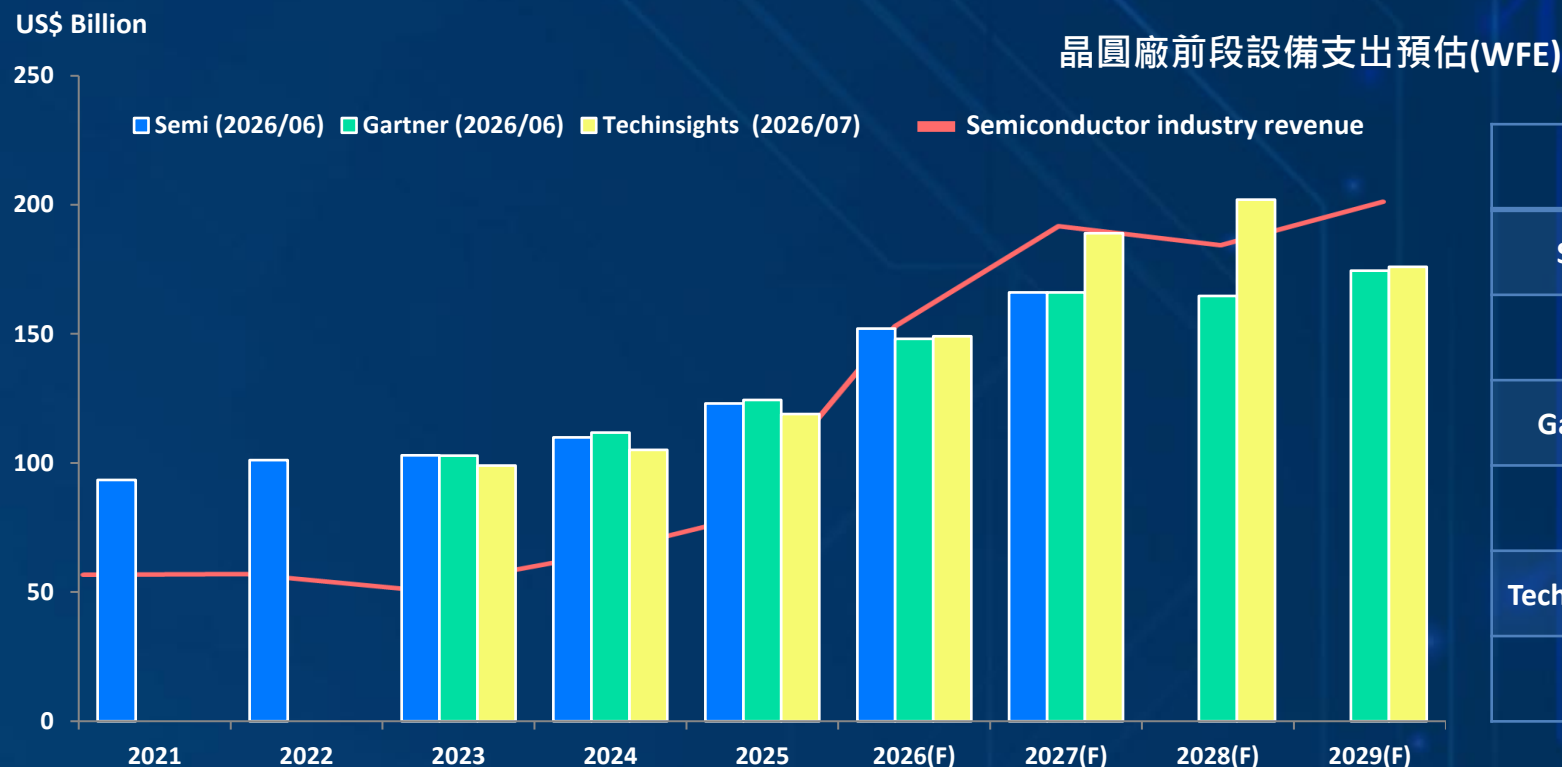
單位：台幣百萬



產業趨勢



- 2026年WFE市場展望持續上修，目前預估成長約19%~25%；隨AI需求持續成長，半導體技術不斷升級、晶圓廠產能持續擴充，進一步帶動設備投資
- 2027年WFE市場預估持續成長，晶圓廠擴產及設備投資規劃持續推進，2028年以後WFE市場規模仍維持高檔
- 隨先進製程、先進記憶體及先進封裝技術持續演進，製程與晶片結構日益複雜，進一步帶動薄膜沉積、蝕刻及檢測等關鍵設備需求增加



WFE(\$B)	2025	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2029(F)
Semi (2026/6)	123	152	166		
YoY	12%	24%	9%		
Gartner (2026/6)	124	148	166	165	174
YoY	11%	19%	12%	-1%	6%
TechInsights (2026/7)	119	149	189	202	176
YoY	13%	25%	27%	7%	-13%

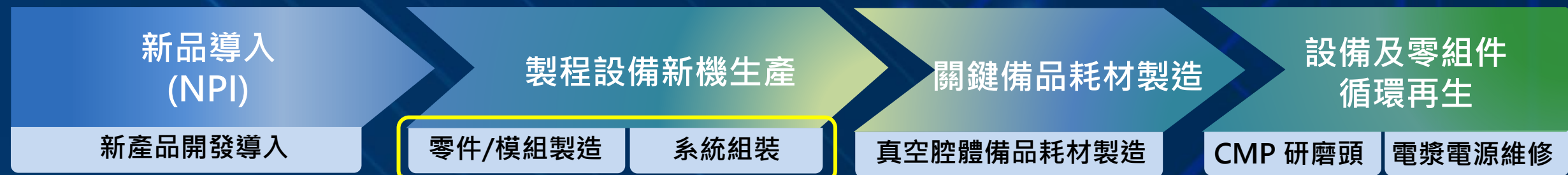
Source:Semi/Gartner/TechInsights

京鼎在產業鏈的定位及市場機會



京鼎是少數能橫跨先進製程到後段封裝的設備製造商，以垂直整合技術能力深度參與全球半導體設備市場的成長

半導體設備生命週期製造服務



全棧垂直整合製造能力



自主研發 - 未來成長動能

營運模式與市場定位

自主研發非製程之自動化設備及微污染防治設備
客戶：半導體前段晶圓廠以及晶圓級先進封裝測試廠

產品組合

微污染防治設備 光罩移載及貼合自動化設備
晶圓外觀檢測設備 晶圓移載搬送自動化設備

2026年第三季展望



■ 本季重點

- Q2營收創單季歷史新高，上半年營收創歷年同期新高；下半年營運表現可望優於上半年
- 泰國春武里廠完成客戶產品認證，7月起逐步放量，產出規模及生產效率持續提升
- 客戶中長期需求持續強勁，通過泰國二期擴產計畫，預計投資美金 2.34 億元，提前布局 2028 年以後產能需求

■ 長期成長動能

- **WFE市場持續擴大**：AI/HPC驅動全球WFE市場結構性成長，帶動先進邏輯、記憶體及先進封裝投資持續增加
- **技術升級及先進封裝推升設備需求**：GAA、HBM及先進封裝等技術持續發展，製程與晶片結構日益複雜，帶動京鼎主要參與的薄膜沉積、蝕刻及檢測等關鍵設備需求增加
- **產品持續多元化**：既有產品需求持續成長，新產品導入專案逐步增加，成長動能同步擴大

Q&A





Thank you

